ファインピッチ BGA の可能性を広げる FO 活用の高密度モジュール

Expanding the Potential of Fine-Pitch BGA with High-Density Modules Utilizing FO Integration

## 概要 Overview

ファインピッチ BGA と周辺部品を一体化し、パッケージ化した高密度モジュール
 A module that integrates fine-pitch BGA and surrounding components into a single package.

# ■特徴 Features

■ 0.3mm ピッチ (フルグリッド)BGA のようなファインピッチ部品は、一般的な貫通基板では配線が困難だが、FO(Fan Out) することで、貫通基板での配線が可能なピッチに拡張できる。この際、共通で使用する周辺部品も同時に取り込む。

Fine-pitch components, such as 0.3mm pitch (full grid) BGA, cannot be routed on standard through-hole boards. However, by utilizing FO (Fan Out), it can widen the pitch to route on through-hole boards. During this process, commonly used surrounding components are also integrated.

⇒FO: Fan Out の略。「扇形 (Fan) に広がる」→「集団などがエリアに広がる」「散らばる」 ⇒FO stands for "Fan Out," meaning spread out or disperse.

- 基板をキャビティ構造とし、BGA を転写実装 The board is designed with a cavity structure to enable the solder transfer mounting of BGA.
- 周辺部品の小型化→0201 サイズの採用 Downsizing of surrounding components is achieved by adopting 0201 size parts.



0.3mm ピッチ BGA があると、 全体がビルドアップ基板が必要 If a 0.3mm pitch BGA is present, the entire assembly requires a build-up PCB.

FO によってピッチ変換したモジュール部品にすることで、一般的な貫通基板への実装が可能 By applying pitch conversion through FO and creating module components, mounting on standard through-hole boards becomes possible

### 当社の特長 Our Strengths

#### 【設計技術】

- ・基板メーカとディスカッションを行い、
  最大限の配線スペックを反映
  CD 5000 伊友
- ・CR-5000 保有

[Design Technology]

- Engage in discussions with PCB manufacturers to reflect the maximum wiring specifications.
- Equipped with CR-5000 design tools.

#### 製品開発 Product Development

新技術の追求 Pursuit of New Technologies

### 材料技術 Material Technology

#### 【製造技術】

- ・0201/1005+大型サイズ部品の混載基板の ランド / はんだマスク開口設計
- ・多様なサイズの部品が混在する基板を通常 仕様のメタルマスクで、スクリーン 印刷を実現

[Manufacturing Technology]

- Design of land patterns and solder mask openings for mixed boards with 0201/1005 and larger components.
- Achieve screen printing on boards with various component

【材料技術/評価技術】 ・はんだペーストメーカと共同開発

・0201 チップを Type5 はんだ ペーストでの 印刷技術

[Material & Evaluation Technology]

- Joint development with solder paste manufacturers.
- Printing technology for 0201 chips using Type 5 solder paste.



設計技術 Design Technology 製造技術 Manufacturing Technology

評価技術 Evaluation Technology sizes using standard metal masks.

【分析技術】 •X線/断面 【Analysis Technology】 •X-ray •Cross-section







分析技術

**Analysis Technology**